

## 開示の要約

### 研磨装置および研磨方法

光源の寿命を正確に決定することができ、さらには、光学式膜厚測定装置の較正をすることなくウェハなどの基板の膜厚を正確に測定することができる研磨装置が開示される。研磨装置は、光を発する光源と、研磨テーブル内の所定の位置に配置された先端を有し、光源に接続された投光ファイバーと、ウェハからの反射光を波長に従って分解して各波長での反射光の強度を測定する分光器と、研磨テーブル内の上記所定の位置に配置された先端を有し、分光器に接続された受光ファイバーと、反射光の強度と波長との関係を示す分光波形に基づいてウェハの膜厚を決定する処理部と、光源に接続された内部光ファイバーと、受光ファイバーまたは内部光ファイバーのいずれか一方を選択的に分光器に接続する光路選択機構を備える。

図 1